

【証券コード：6728】

# 決算説明会資料

2019年度（FY2019）

第2四半期（累計）（2019年7月～2019年12月）

2020年2月14日

株式会社 アルバック

## ◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるFPD（フラット・パネル・ディスプレイ）・半導体・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## ◆本資料における表示方法について

（特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです）

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q（累計）： 第2四半期連結累計期間

2Q： 第2四半期連結会計期間

## □ 受注高 720億円（前年同期比▲40% 当初予想比▲27%）

- 大型TV用LCD投資商談が一巡し、スマートフォン用OLED投資も一時的調整局面にあることから、前年同期比大幅減少

## □ 売上高 967億円（前年同期比▲17% 当初予想比▲1%）

- 前年同期比減少もほぼ当初予想通り

## □ 営業利益 84億円（前年同期比▲46% 当初予想比▲1%）

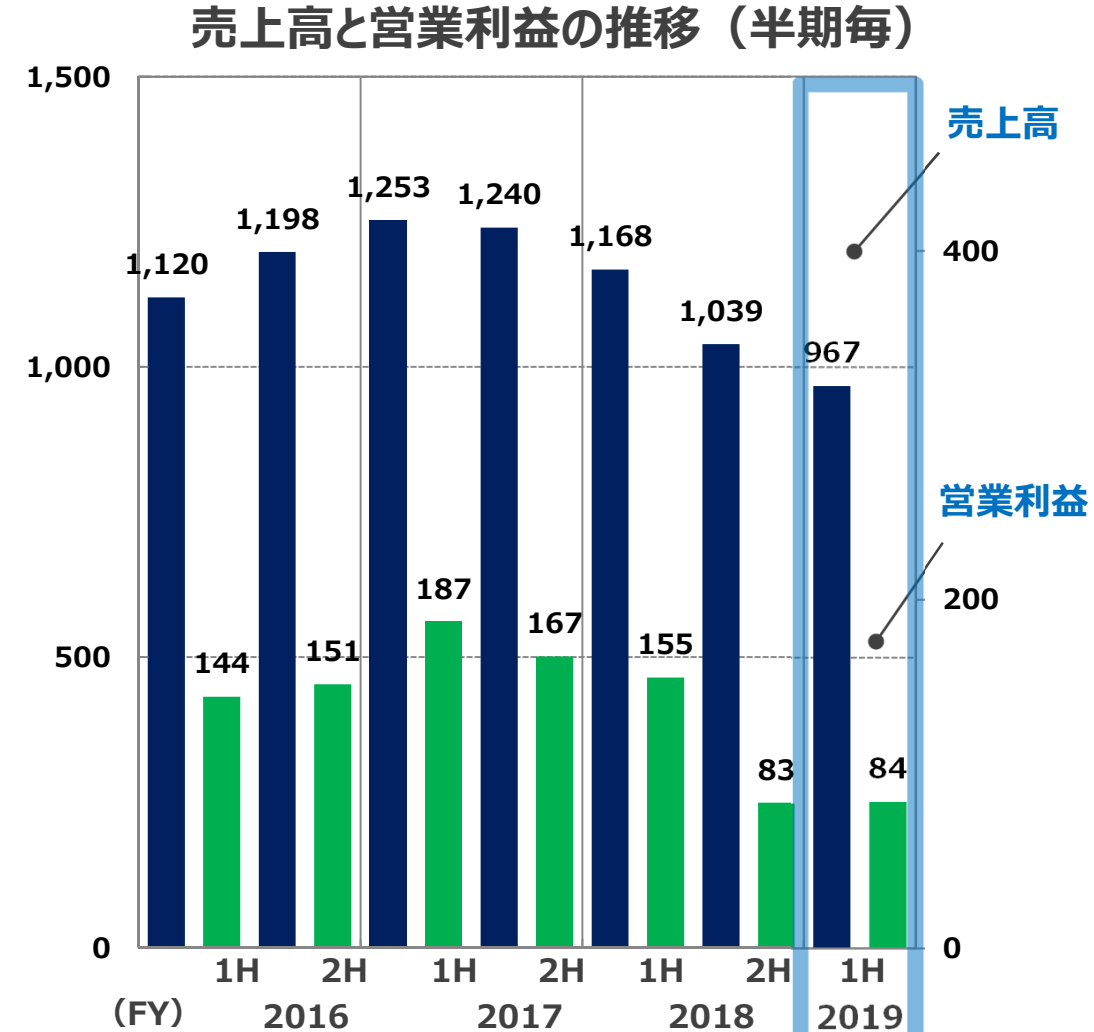
- 売上高同様、前年同期比減少もほぼ当初予想通り

# 2019年度2Q（累計）連結業績概要

- ・ 受注高：大型TV用LCD商談一巡、スマートフォン用OLED投資延期等により、前年同期比大幅減少、当初予想も下回る
- ・ 売上高：FPD関連に加え、コンポーネントなどが前年同期比減少するも、ほぼ当初予想通り
- ・ 営業利益：ほぼ当初予想通り

【単位：億円】

	(参考) 2018年度 上期実績	当初予想	2019年度2Q（累計）		当初予想比 増減率
			実績	対前年同期 増減率	
受注高	1,195	986	<b>720</b>	-39.7%	-27.0%
売上高	1,168	975	<b>967</b>	-17.2%	-0.8%
売上総利益	348	-	<b>257</b>	-26.2%	-
率	29.8%	-	<b>26.5%</b>	- 3.3 pt	-
販管費	193	-	<b>173</b>	-10.5%	-
営業利益	155	85	<b>84</b>	-45.8%	-1.2%
率	13.3%	8.7%	<b>8.7%</b>	- 4.6 pt	- 0.0 pt
経常利益	164	90	<b>99</b>	-39.2%	10.5%
率	14.0%	9.2%	<b>10.3%</b>	- 3.6 pt	+ 1.1 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	112	60	<b>78</b>	-30.7%	29.8%
率	9.6%	6.2%	<b>8.0%</b>	- 1.6 pt	+ 1.9 pt

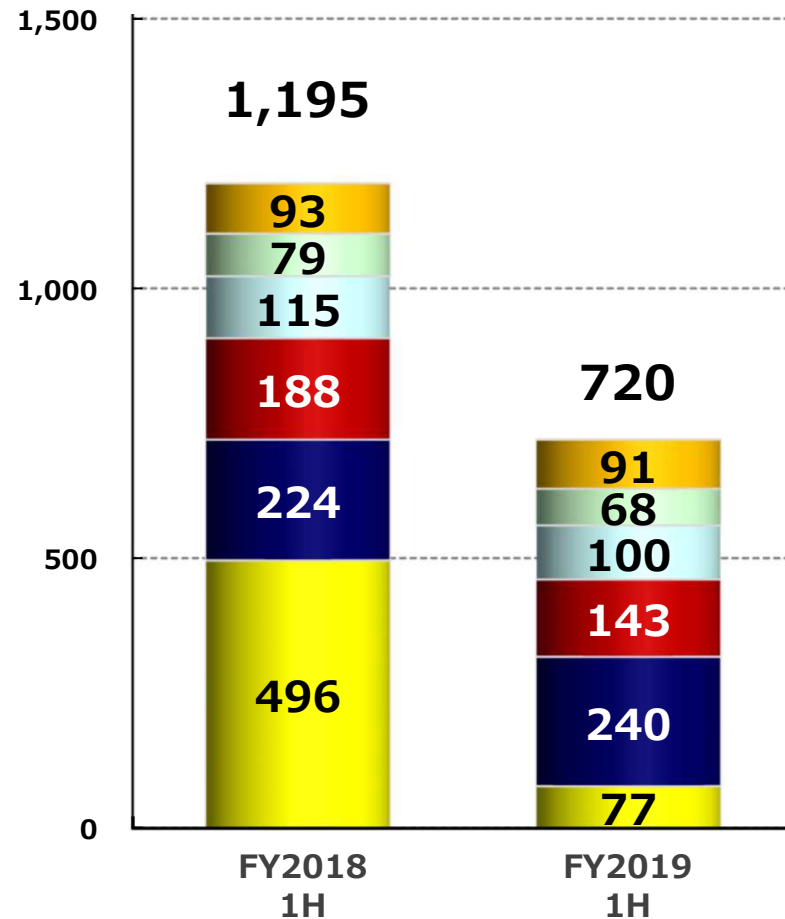


# 2019年度2Q（累計）連結業績概要（品目別受注高）

- FPD・PV製造装置：大型TV用LCD商談の一段落、スマートフォン用OLED投資延期等により、前年同期比大幅減少
- 半導体・電子部品製造装置：パワーデバイスや通信デバイス、ロジック等が好調で前年同期比増加
- コンポーネント：前年同期の大ロスロット案件（1Q）の反動減に加え、自動車・FPD関連の投資減速等により減少

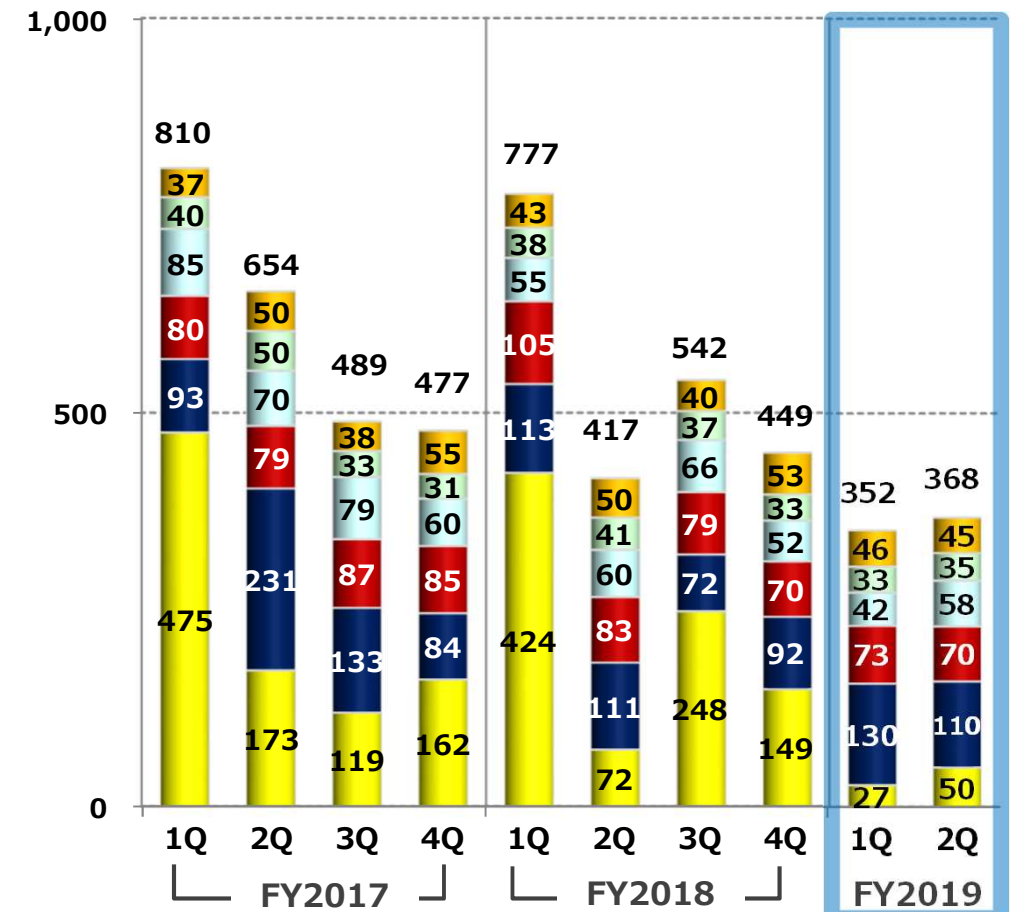
前年同期比

【単位：億円】



四半期推移

【単位：億円】



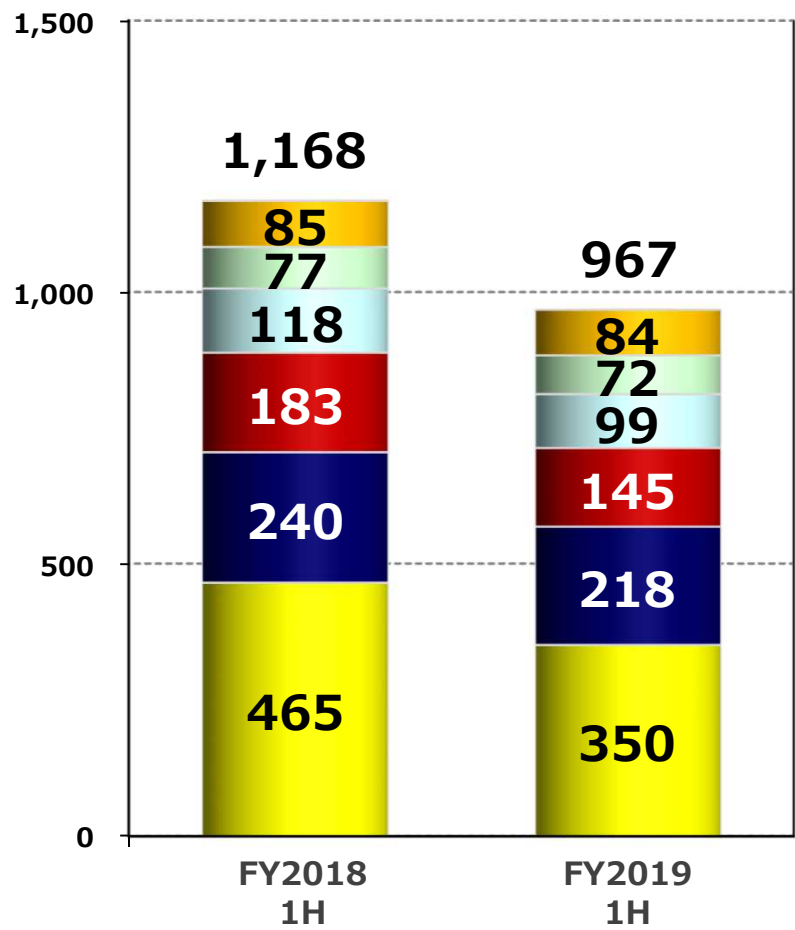
- その他
- 材料
- 一般産業用装置
- コンポーネント
- 半導体及び電子部品製造装置
- FPD及びPV製造装置

# 2019年度2Q（累計）連結業績概要（品目別売上高）

・ FPD・PV製造装置：期初受注残高が相当水準あったことから、受注減少の上期影響は限定的で当初予想を若干下回る

## 前年同期比

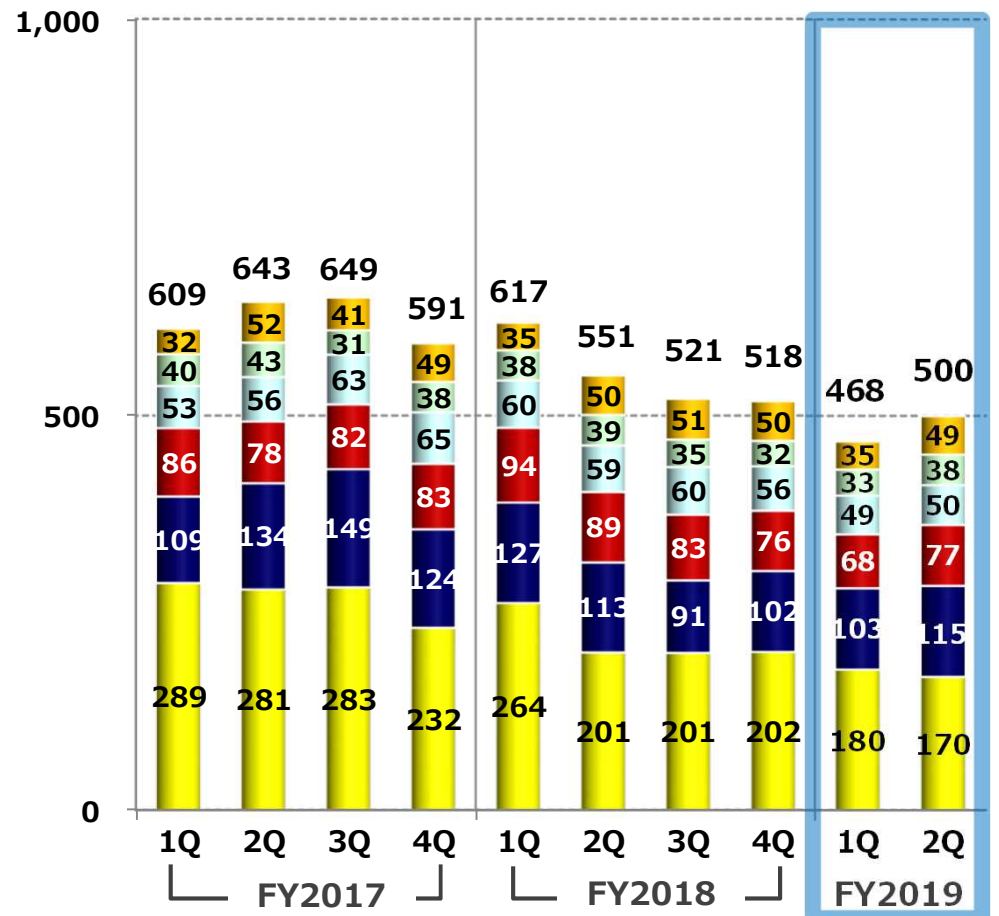
【単位：億円】



- その他
- 材料
- 一般産業用装置
- コンポーネント
- 半導体及び電子部品製造装置
- FPD及びPV製造装置

## 四半期推移

【単位：億円】

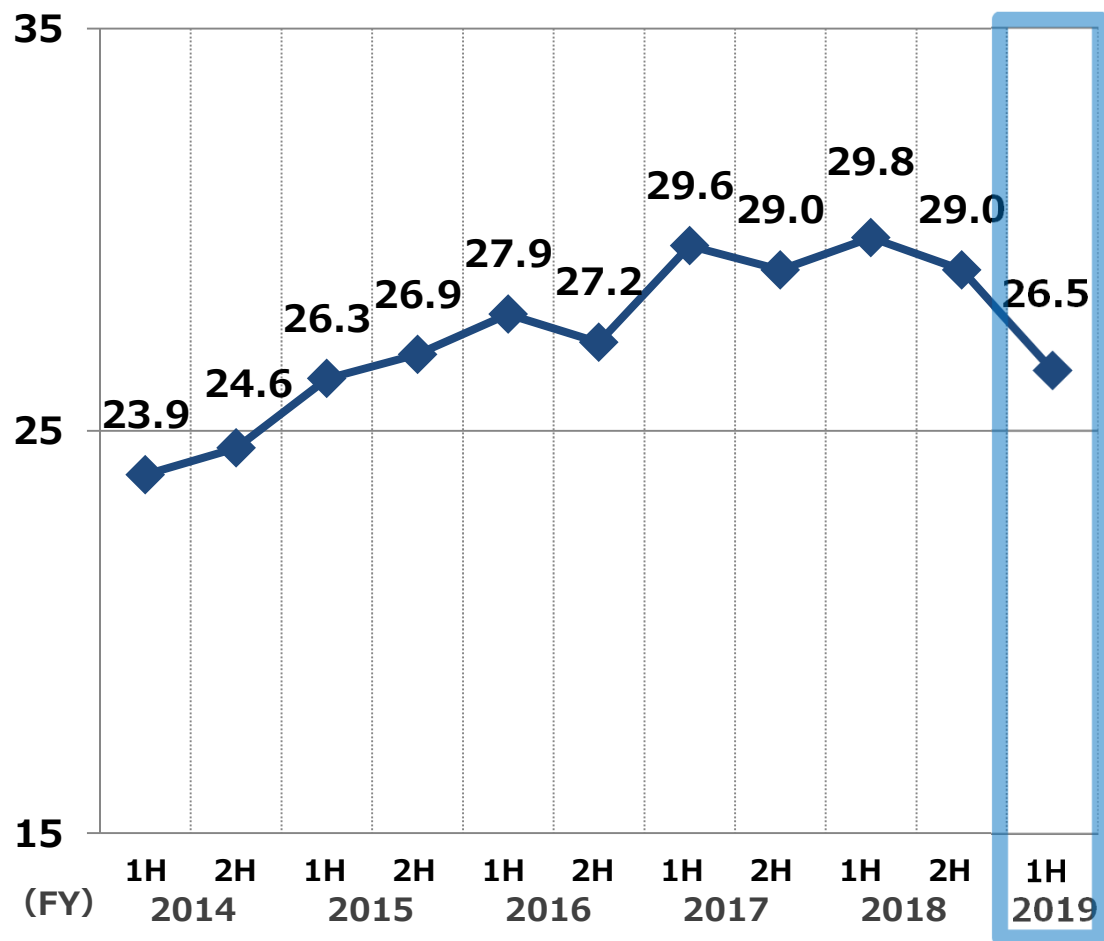


# 2019年度2Q（累計）連結業績概要（利益率）

- 売上総利益率、営業利益率は売上減少の影響等により低下（契約解除を除くと売上総利益率は28.4%）

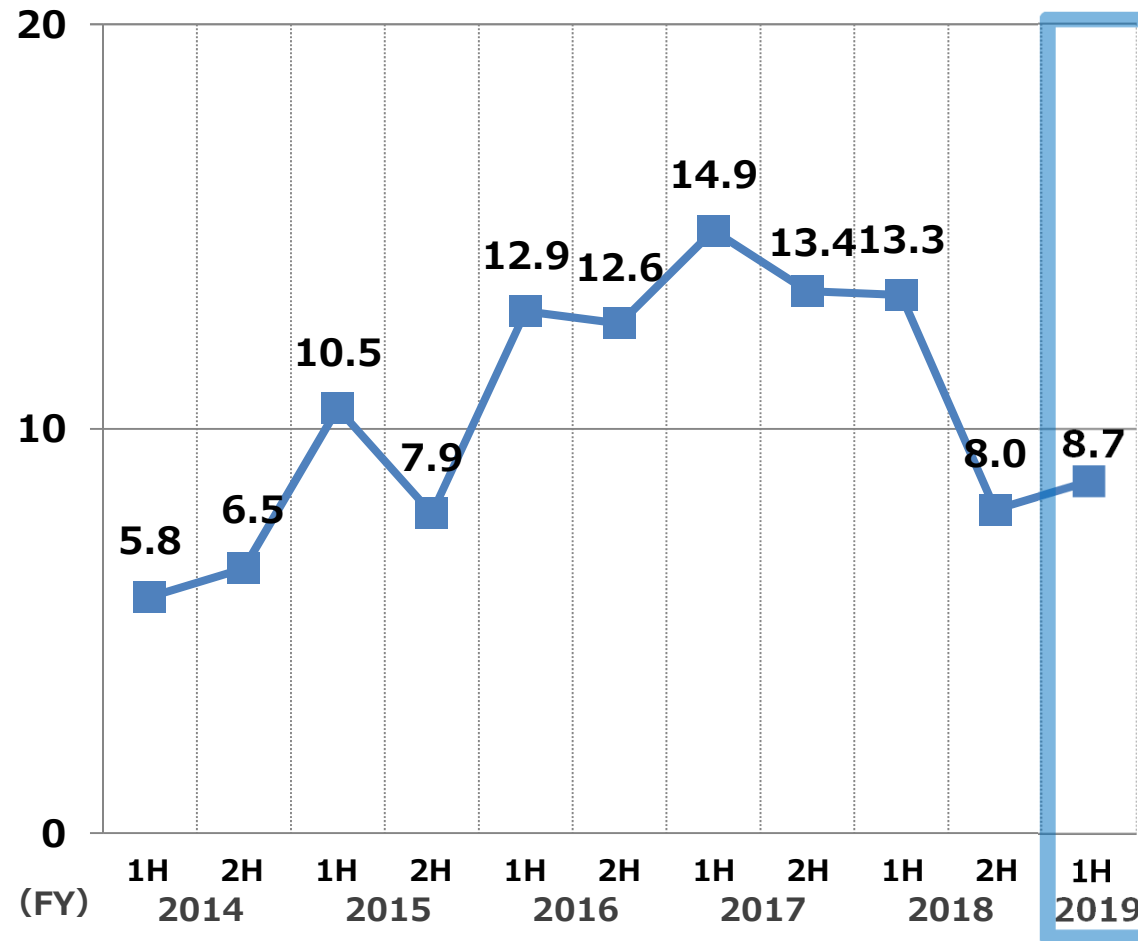
## 売上総利益率

【単位：%】



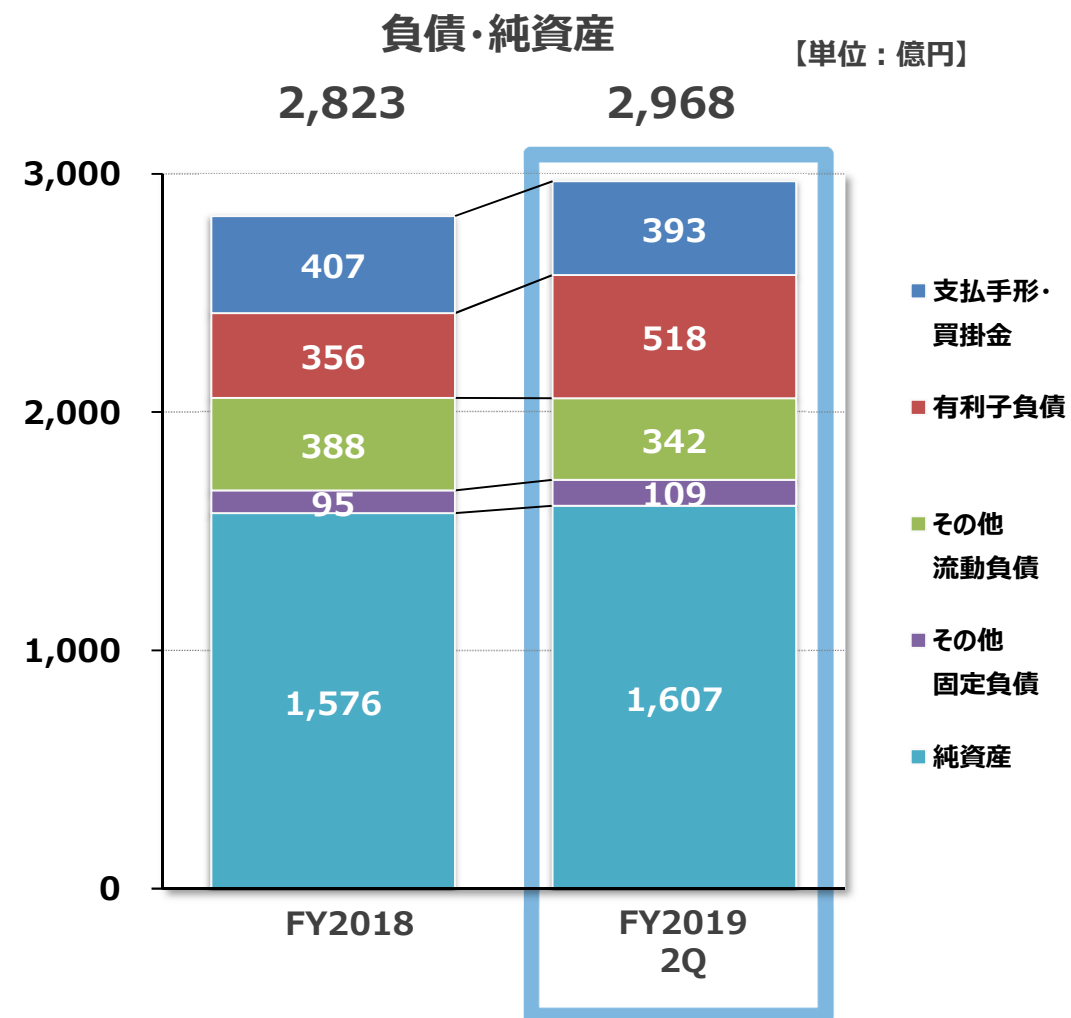
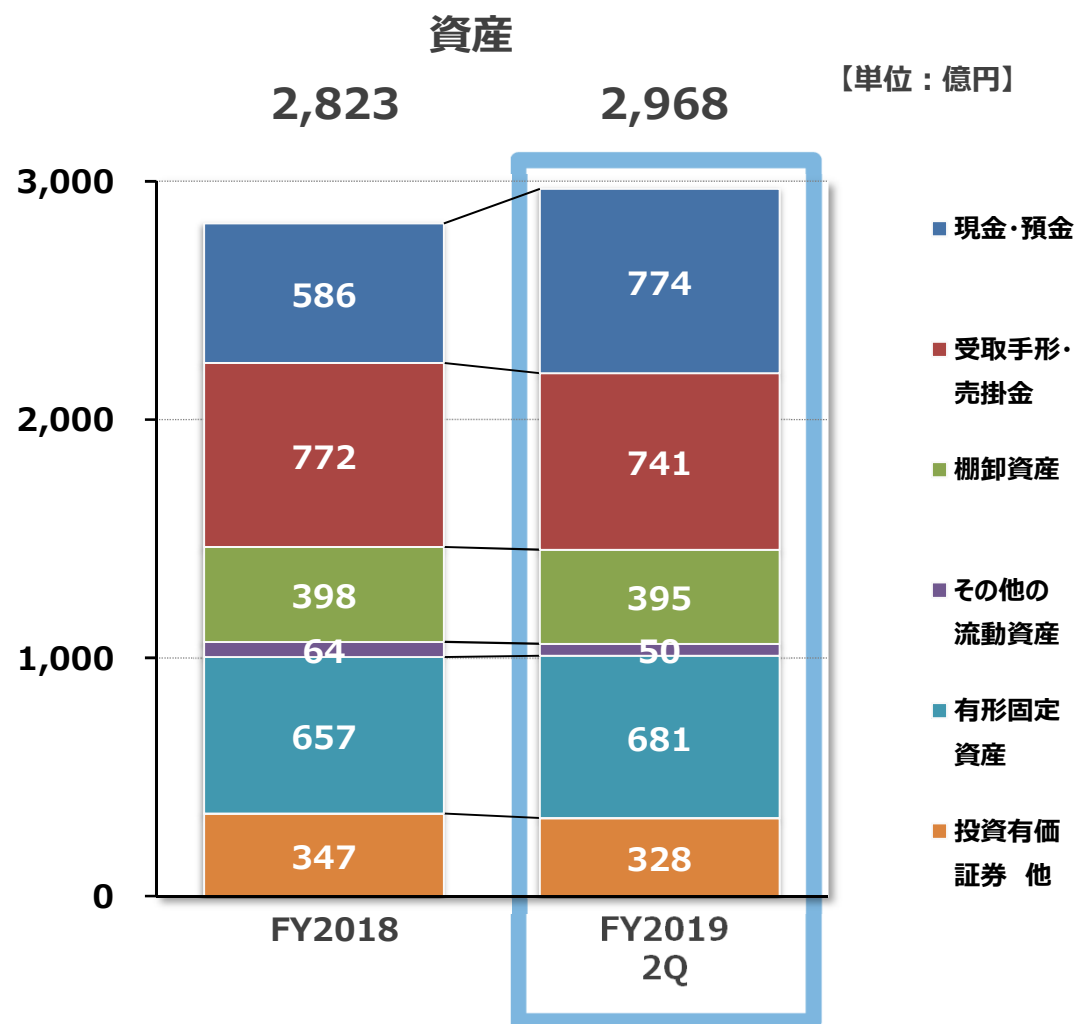
## 営業利益率

【単位：%】



# 2019年度2Q連結業績概要（連結貸借対照表）

- 現金・預金188億円増加、有利子負債162億円増加、総資産145億円増加。
- 純資産31億円増加、自己資本比率51.9%。







# 2019年度連結業績予想と事業環境

# 2019年度通期業績予想の修正

- FPD関連の受注減少による売上高及び営業利益の減少が見込まれること、開発投資等による固定費が増加することから、売上高及び各利益項目を下方修正

【単位：億円】

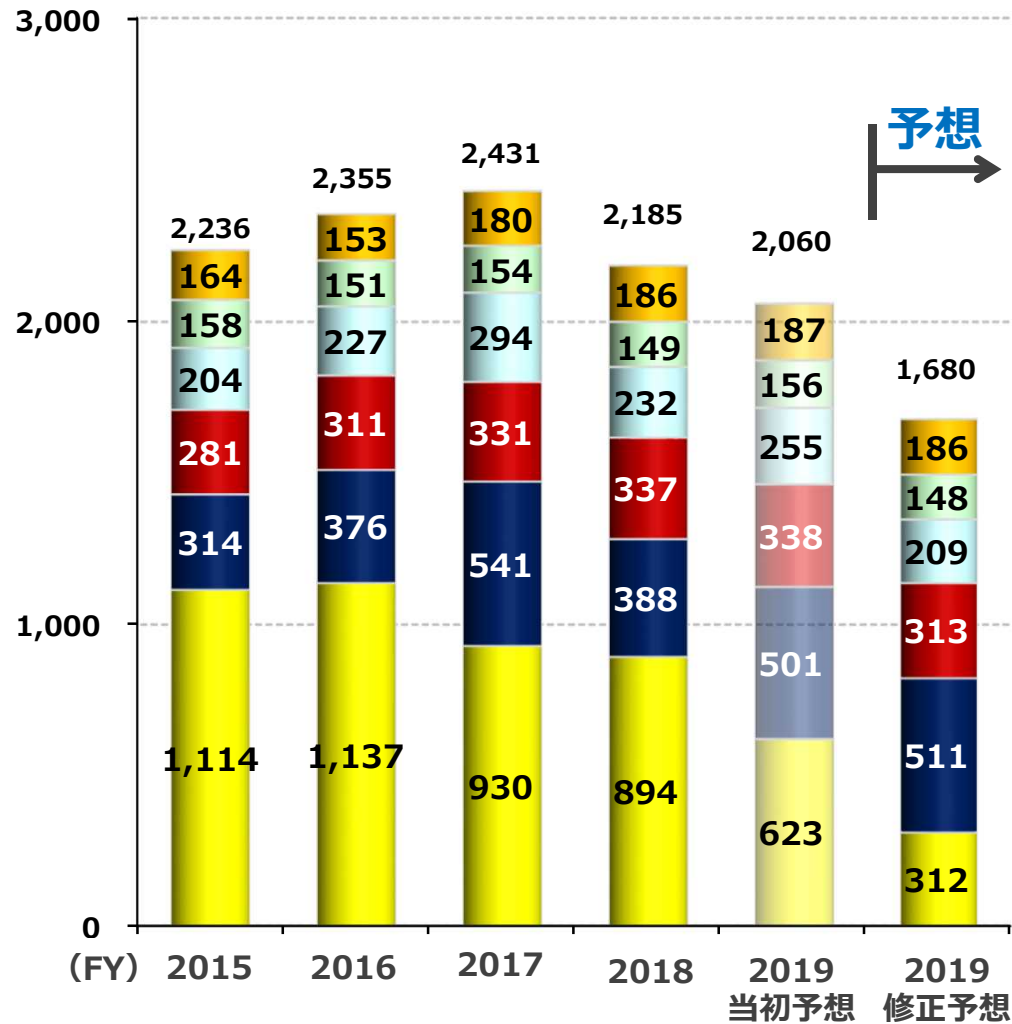
	(参考) 2018年度 通期実績	2019年度					
		2Q累計		通期			
		当初予想	実績	当初予想	今回予想	前年同期比	当初予想比
受注高	2,185	986	<b>720</b>	2,060	<b>1,680</b>	-23.1%	-18.4%
売上高	2,207	975	<b>967</b>	2,050	<b>1,980</b>	-10.3%	-3.4%
営業利益	238	85	<b>84</b>	225	<b>150</b>	-37.0%	-33.3%
率	10.8%	8.7%	<b>8.7%</b>	11.0%	<b>7.6%</b>	- 3.2 pt	- 3.4 pt
経常利益	256	90	<b>99</b>	235	<b>166</b>	-35.1%	-29.4%
率	11.6%	9.2%	<b>10.3%</b>	11.5%	<b>8.4%</b>	- 3.2 pt	- 3.1 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	187	60	<b>78</b>	155	<b>108</b>	-42.1%	-30.3%
率	8.5%	6.2%	<b>8.0%</b>	7.6%	<b>5.5%</b>	- 3.0 pt	- 2.1 pt

※新型コロナウイルスの影響は見込んでいません。

# 2019年度通期業績予想の修正（品目別 受注・売上）

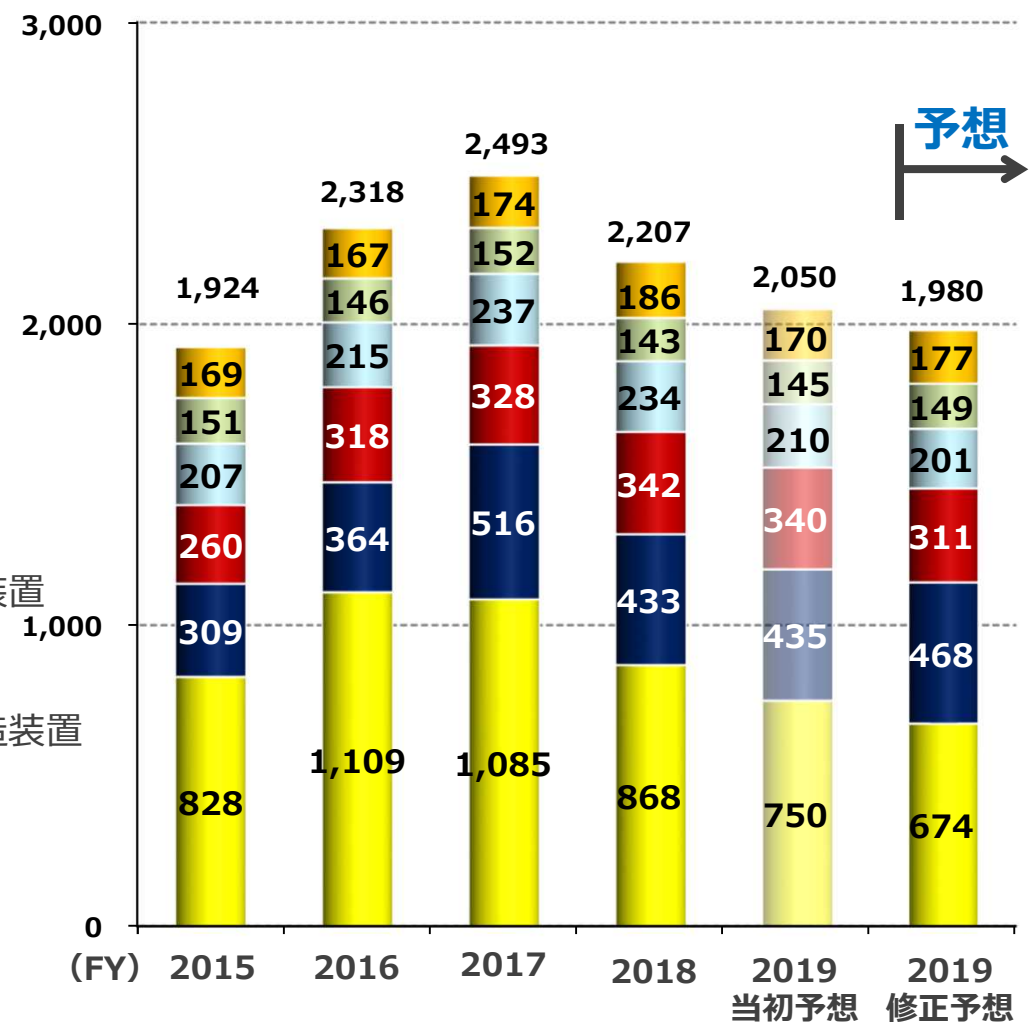
## 受注高

【単位：億円】



## 売上高

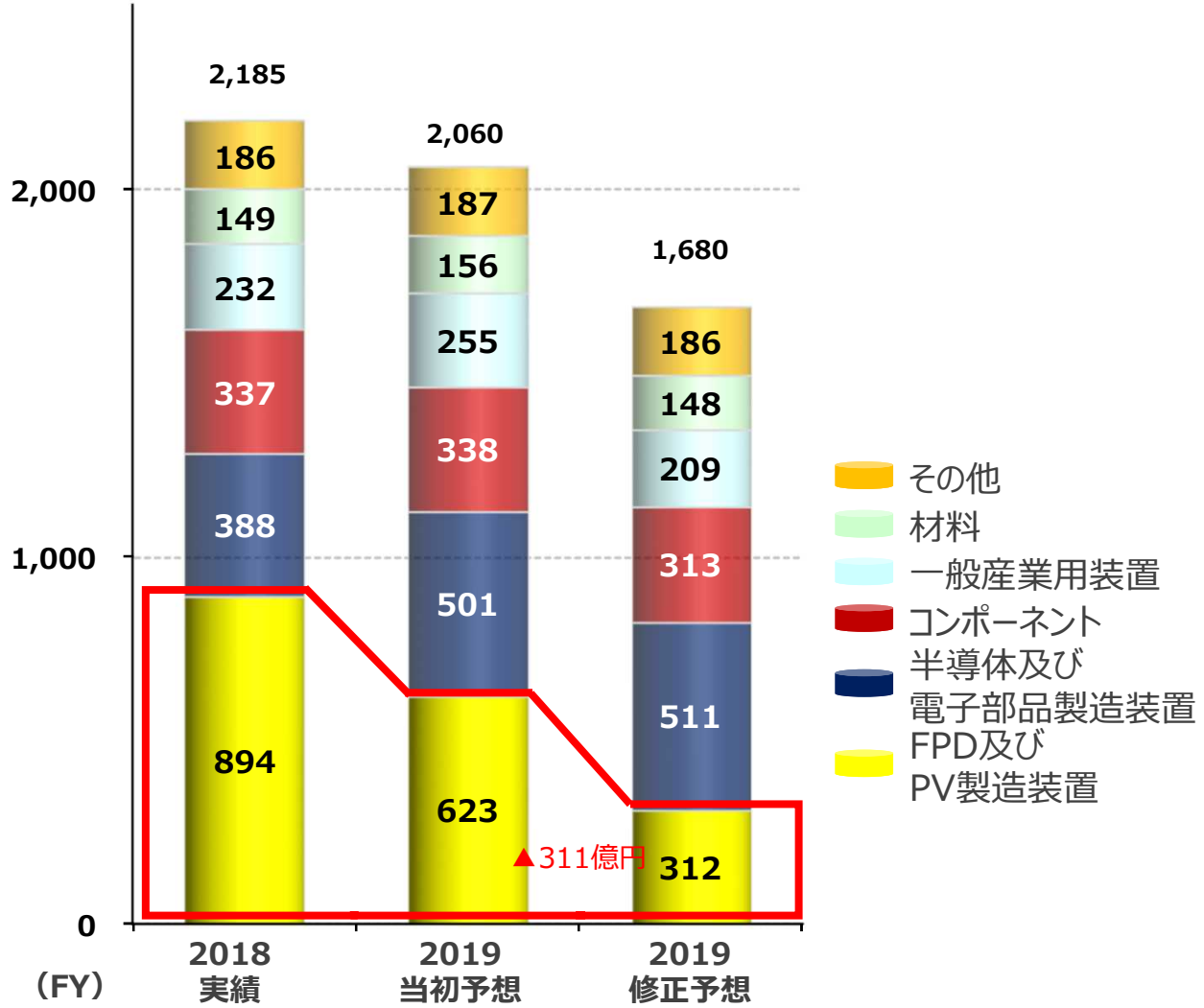
【単位：億円】



# 2019年度通期業績予想の修正（FPD受注）

## 受注高

【単位：億円】



【期初】18年度894億円⇒623億円の予想

要因

- ①大型TV用LCD商談一段落
- ②スマートフォン用OLEDの当社客先大型投資計画は20年度の予定

【上期実績】上期77億円（社内計画比▲約220億円）

要因：上期に見込んでいた

- ①スマートフォン用OLED投資延期
- ②大型TV用LCDの追加投資延期（中国のG10.5工場稼働開始でパネル価格下落）
- ③受注取消等

【通期予想】623億円⇒312億円（▲311億円）

要因：下期に見込んでいた

- ①大型TV用LCDの追加投資延期
- ②スマートフォン用OLED投資延期

足下

期初より受注減を見込んでいたが、今期受注見込みだった①大型TV用LCDの追加投資延期、②顧客OLED投資（バックプレーン用スパッタリング装置）延期などにより当社予想比、受注は大幅減少見込み

2018 2019 2020 2021 2022以降

大型TV用LCD投資（中国G10.5）  
19～21年：順次稼働⇒パネル価格下落  
⇒韓国：ライン閉鎖、中国：一部追加投資継続



スマートフォン用OLED投資（中国）  
⇒一時的な調整局面  
（当社客先の蒸着機大口商談は20年度以降）

パネル投資は用途拡張性の高いOLED中心に

- ・フレキシブル: フォルダブル、車載用、ローラブル
- ・薄く軽量: 壁掛け大型ディスプレイ、ローラブル

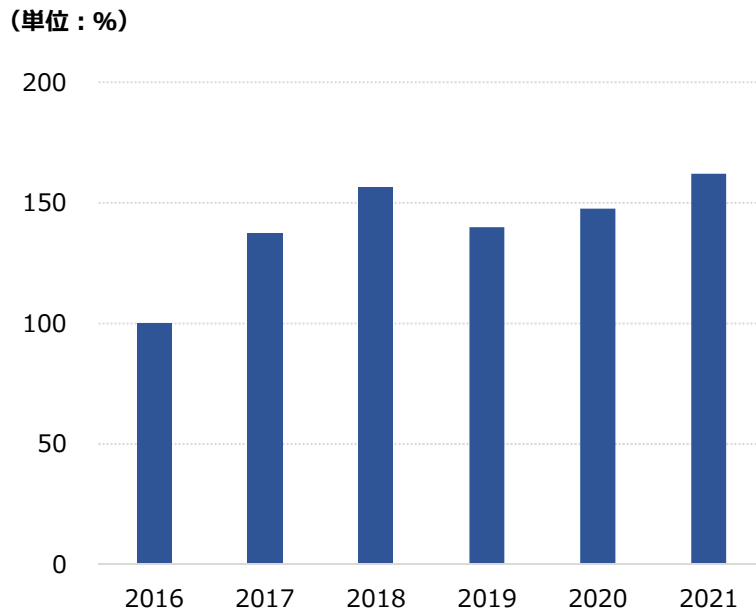


中・大型基板OLED市場拡大⇒22年以降貢献

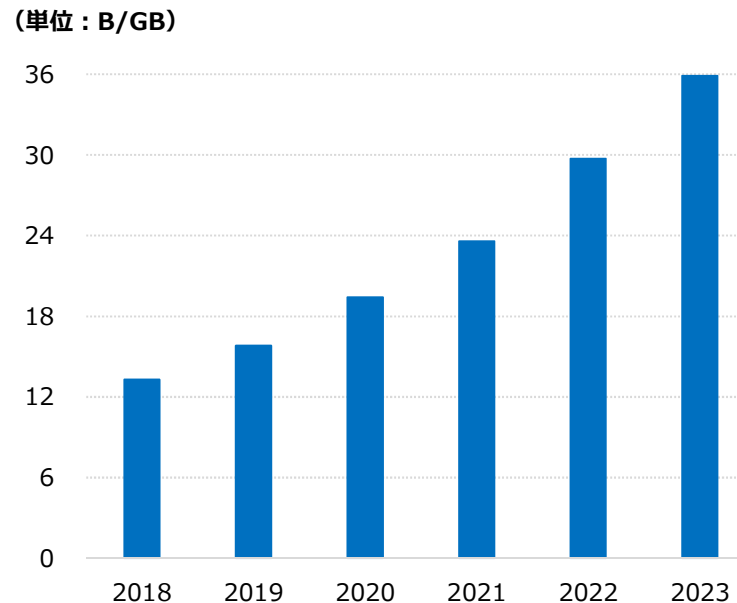
- ・大型基板のスパッタリング・搬送技術等の強みを  
生かしてトップメーカーと量産開発連携

- ✓ メモリ投資の下期回復を見込んでいたが回復が遅れ、20年度からの本格回復を見込む
- ✓ NAND：トップメーカー投資再開、他社慎重姿勢（20年年央再開見込み）
- ✓ DRAM：メモリ価格が下げ止まり、各社投資再開に期待

半導体装置市場の見通し (SEMI)  
2016年 = 100

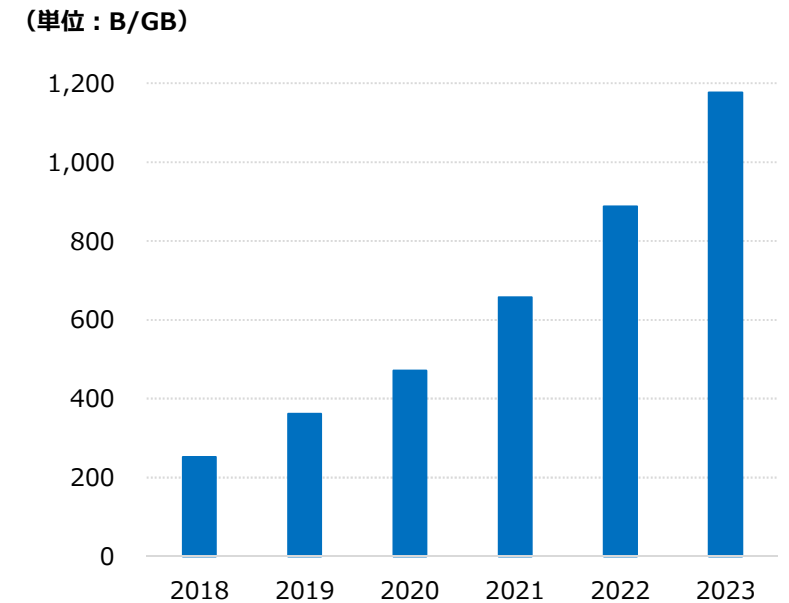


DRAM需要 (出荷容量) 予測



出所：Gartner

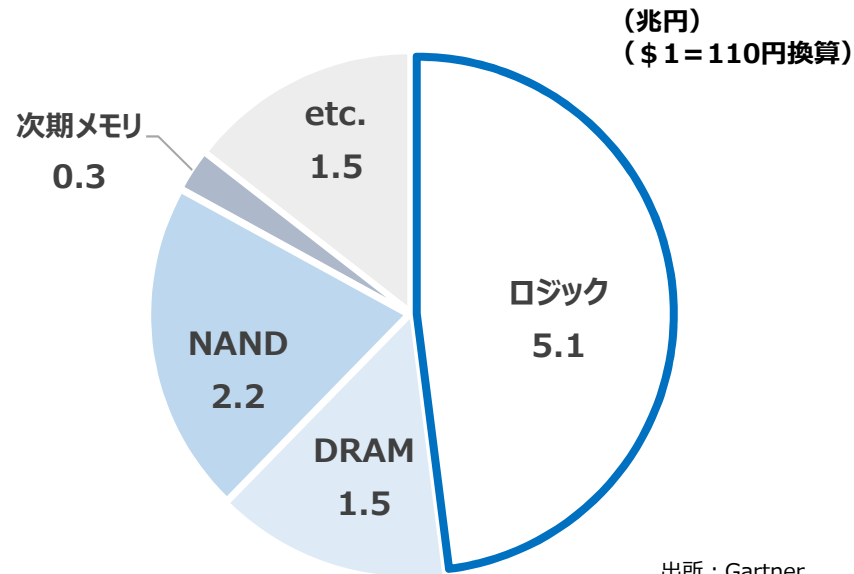
NAND需要 (出荷容量) 予測



出所：Gartner

- ✓ EUV採用で微細化が求められるロジック用スパッタリングプロセス（メタル・ハード・マスク）で大手2社に参入（両社とも今後の優先投資分野）
- ✓ 今期は計画通りの受注を見込み、今後は、①顧客のビジネス拡大、②更なる微細化プロセスでの採用工程増、③参入企業増加により、成長を狙う

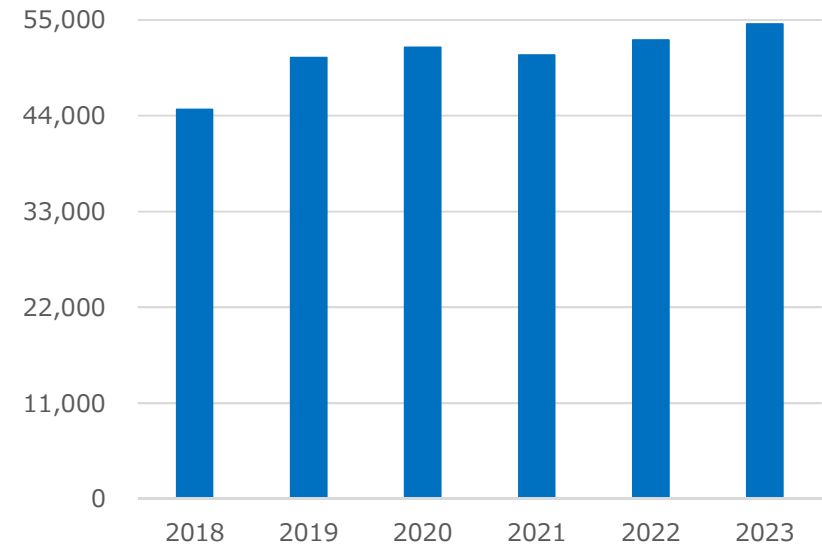
### 半導体設備投資額（2019年）



出所：Gartner

### ロジック設備投資

(単位：億円)



出所：Gartner

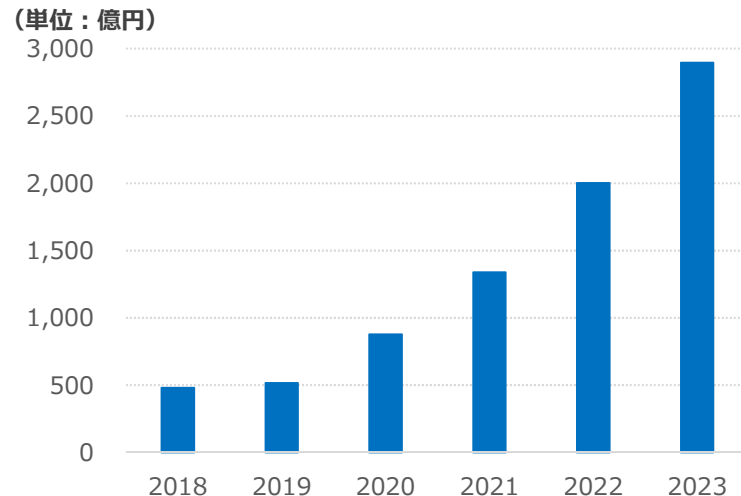


# 半導体の市場環境③ 新型不揮発性メモリ (PCRAM)

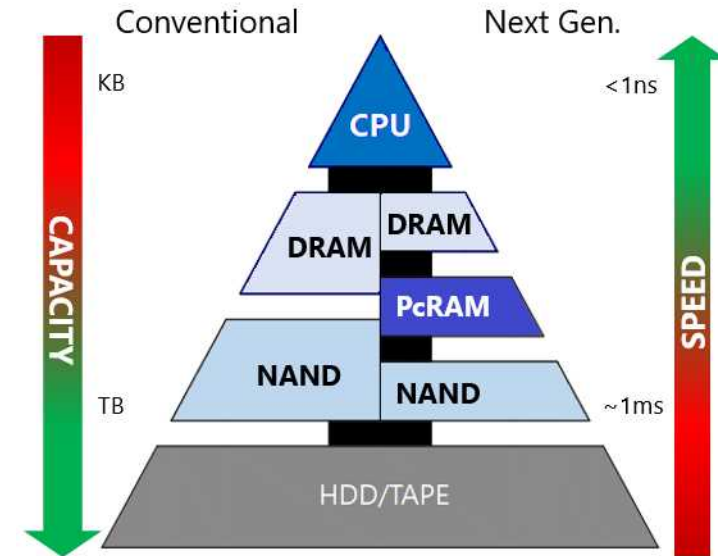
## 新型不揮発性メモリ

- ✓ ① NAND比処理スピード速く、② DRAM比不揮発性（電源が切れても記憶保持）を兼ね備え「PCRAM」の重要なスパッタリング工程で唯一量産実績を持つ
- ✓ 既に量産実績があり、開発機納入先も増加し、すそ野拡大
- ✓ 大容量情報のスピード処理と低消費電力化を実現 ⇒ 中長期的な成長を見込む  
⇒ 5G・IoT・AIによるデータの大容量化・低遅延化に対応、サーバー、エッジコンピュータ、PCへと用途拡大

### Emerging Memory 市場規模



注：Emerging MemoryにはMRAM, ReRAM, PcRAMなどが含まれる  
出所：Gartner



- ✓ 5G・IoT（通信デバイス・光デバイス・センサ等）の本格普及に向け、設備投資は堅調に進む  
デバイスの微細化・高性能化の課題解決に対応
- ✓ 低消費電力ニーズ（自動車・電動化・家電等）に対応する、パワーデバイス投資継続



## 通信デバイス

基地局用アンテナ向け部品、  
SAW・BAWフィルタ



## センサ etc

指紋・イメージ・光センサ 等

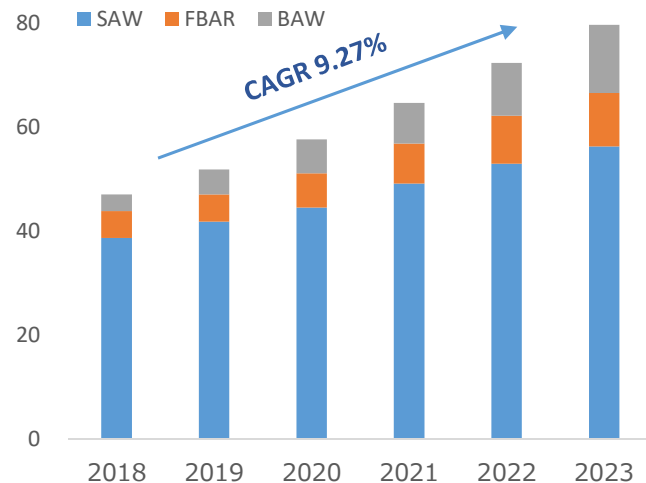


## パワーデバイス

Si-IGBT（日本）  
SiC向け（中国）

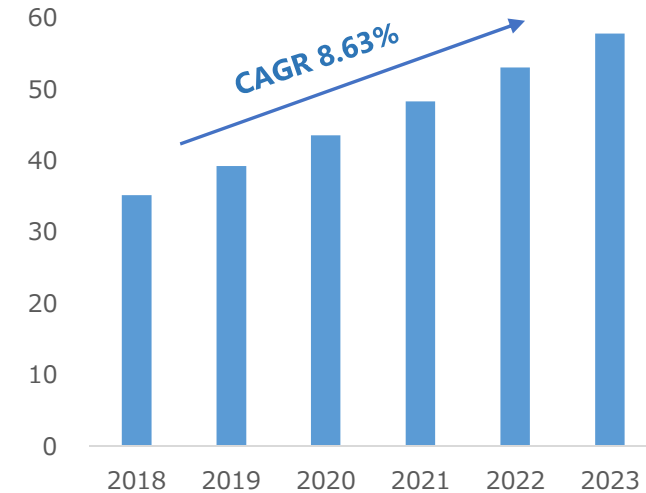
### Communication Device市場規模

(単位：Billion Unit)



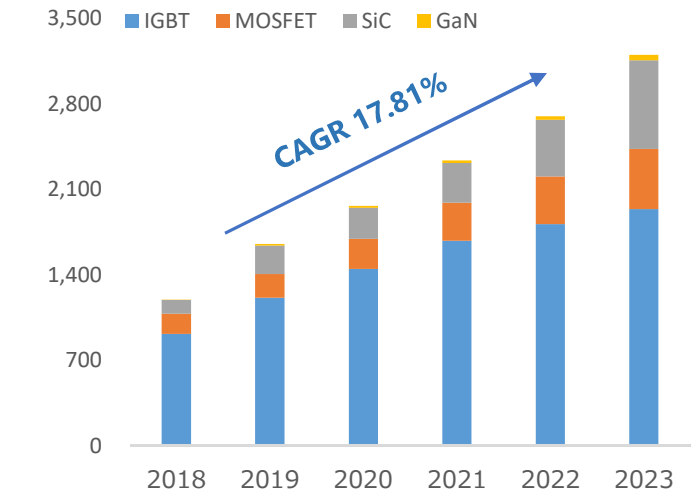
### Sensor市場規模

(単位：billion US\$)



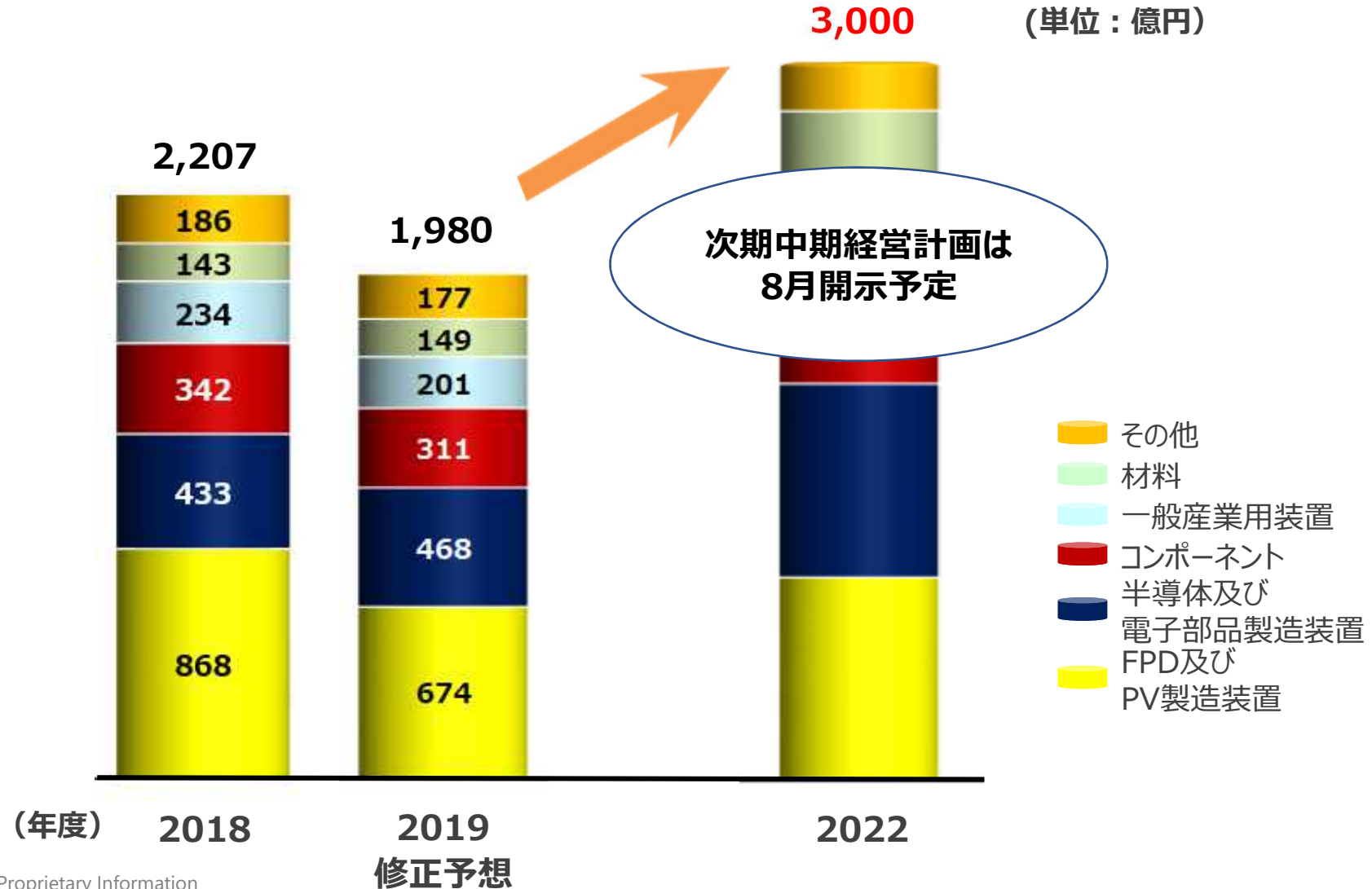
### EV/HEV Power Device市場規模

(単位：Million US\$)



# 次期中期経営計画

既に着手している経営基盤強化のための経営改革と成長戦略を取り込んだ次期中期経営計画について8月に開示予定





# さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術



**Automobile**  
自動車



**Semiconductor**  
半導体



**Flat Panel Display**  
フラットパネルテレビ



**Photovoltaic**  
太陽電池



**Food Processing**  
食品



**Aircraft**  
航空



**Bio**  
バイオ



**Smart Phone**  
スマートフォン



**Magnetic Device**  
磁気デバイス



**Home Appliance**  
家電製品



**Aerospace**  
宇宙産業



**Pharmaceutical**  
医療・薬剤



**Wearable/VR**  
ウェアラブル/VR



**Power Device**  
パワーデバイス



**MEMS Device**  
MEMS デバイス



**Architectural Glass**  
建材・スマートガラス



**Optical**  
光学



**Flexible**  
フレキシブル



**Packaging Materials**  
パッケージング



**Next Generation Light**  
次世代照明

真空テクノロジーで /  
「つくる」をつくる

**ULVAC**